

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2026-044

## 深圳市德明利技术股份有限公司

# 关于增加公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信/借款额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 4 日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于增加公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信/借款额度的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、已批准的公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信/借款额度概述

公司于 2026 年 3 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信/借款额度及接受关联方担保的议案》。前述会议同意公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 150 亿元人民币的综合授信/借款额度，以上综合授信/借款额度可循环使用，并同意公司实际控制人李虎、田华为公司及控股子公司向金融机构申请综合授信/借款额度及其他业务提供无偿连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 130 亿元，担保额度在有效期内可循环使用。上述综合授信/借款额度、授权及接受关联方担保的总额度有效期自本议案获公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日的前一日止。

### 二、本次增加公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信/借款额度的基本情况

为满足公司及控股子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及控股子公司 2026 年度拟向银行等金融机构增加申请不超过 150 亿元人民币的综合授信/借款额度，并在额度内签署相关综合授信/借款协议。综合授信/借款品种包括但不限于：贷款、银行

承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款、外汇及其衍生品等，申请授信/借款额度的条件为各合作金融机构认可的抵/质押物、保证担保。上述增加的综合授信/借款额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金需求及与相应金融机构达成的实际授信额度/借款额度来确定，综合授信/借款额度可循环使用。

上述增加的综合授信/借款额度内的单笔融资原则上不再提交董事会审批。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东会授权董事长暨法定代表人李虎先生依据公司及控股子公司的实际运营资金需要，在增加的综合授信/借款额度范围内决定办理综合授信/借款额度申请等具体事宜，并由董事长暨法定代表人李虎先生或其授权的具体授信/借款业务所涉控股子公司的法定代表人/董事签署相关协议和其他法律文件。

上述增加的综合授信额度/借款额度及授权有效期均为自本议案获股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日的前一日止。

本次增加人民币 150 亿元综合授信/借款额度后，公司及控股子公司 2026 年向金融机构申请综合授信/借款总额度合计不超过人民币 300 亿元。

除上述增加的人民币 150 亿元综合授信/借款额度外，公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信/借款额度事项的有效期限截止日、授权事宜、授信品种及接受公司实际控制人李虎、田华担保的总额度均与公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信/借款额度及接受关联方担保的议案》的相关内容一致。

本次增加人民币 150 亿元综合授信/借款额度事项尚须提交公司股东会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四十三次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2026年6月5日